

工业和信息化部工业文化发展中心

2026科技金融赋能产业升级对接会暨先进制造业集群金融服务“同心圆”活动

各有关单位：

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议、全国新型工业化推进大会精神，落实《关于金融支持新型工业化的指导意见》要求，推动金融资源向产业集群聚集和专业化发展，探索金融助力先进制造业集群培育的有效路径，工业和信息化部工业文化发展中心将联合北京经济技术开发区管理委员会、中国建设银行股份有限公司北京市分行于2026年1月22日在荣华天地酒店（北京市大兴区荣华街道荣华南路1号院3号楼）组织开展“2026科技金融赋能产业升级对接会暨先进制造业集群金融服务‘同心圆’活动”。届时，相关政府部门领导、金融机构、高校及科研院所、重点企业代表等将出席本次活动。

诚挚邀请贵单位领导拨冗出席，感谢您的支持。

特此致函。

附件：活动议程

工业和信息化部工业文化发展中心

2026年1月19日

（联系人：周思源 010-68209942/17310310070）

附件

活动议程

1月22日上午：科技金融赋能产业升级对接会		
开 场 发 言		
9:30—9:45	领 导 致 辞	工业和信息化部工业文化发展中心
		北京经济技术开发区管理委员会
		中国建设银行公司业务部
主 题 分 享		
9:45—10:35	聚焦科创耐心资本，新型政策工具和资产证券化	
	建立集群金融新范式，助力打造新质生产力	
	建设银行“善建科技”科技金融服务体系介绍	
创 新 发 布		
10:35—10:55	中国建设银行北京市分行集成电路集群预授信方案发布	
	建设银行北京分行出海业务方案解读	
	中国建设银行“集群快贷”发布	
签 约 仪 式		
10:55—11:00	中国建设银行“集群快贷”北京地区首笔签约仪式	
路 演 亮 相		
11:00—11:40	京津冀智能网联新能源汽车集群项目路演	
1月22日下午：人工智能集群产融对接会		
14:00—16:40	人工智能前沿技术分享	
	人工智能投融资趋势与投资机会分享	
	科技金融产品及服务介绍	
	人工智能优质项目分享及点评	
	现场企业融资需求交流对接	